

晶圆外观检测设备产品系列

Wafer Appearance Inspection Equipment Product Series

晶圆级



WS600/WS602

2D Inspection

- 面向激光雷达芯片等
- 4 & 6Inch有图形晶圆检测



WS1100

2D Inspection

- 面向CIS芯片等
- 8 & 12 Inch有图形晶圆检测
- No Notch Glass Wafer
- 1 Objectives: Area Scan



WST1200

2D+3D Inspection

- 面向CIS芯片等
- 8 & 12 Inch有图形晶圆检测
- 1 Objectives: Line Scan
- LCI 3D Model



Dolphin100

2D Inspection

- 面向COMS图像传感器、AR、VR、玻璃光学镜头等
- 4 & 6 Inch有图形晶圆检测
- 8 & 12 Inch 有图形晶圆检测

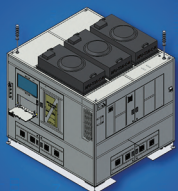


Dolphin200

2D Inspection

- 面向Logic、MEMS、Memory、RF、Power、FOWLP、WLCSP、Bumping、Chiplet等
- 4 & 6 Inch有图形晶圆检测
- 8 & 12 Inch 有图形晶圆检测

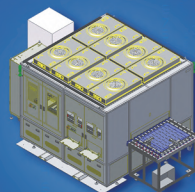
板级



Seal 100G

2D Inspection

面向510*515mm、600*600mm玻璃板级封装线路进行2D缺陷检测测量



Seal 100G SII

2D Inspection

面向920*730mm、650*750mm玻璃板级封装线路进行2D缺陷检测测量

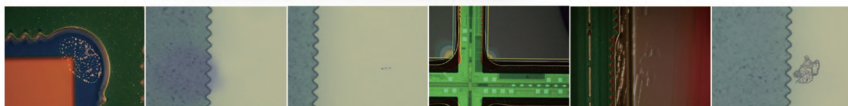
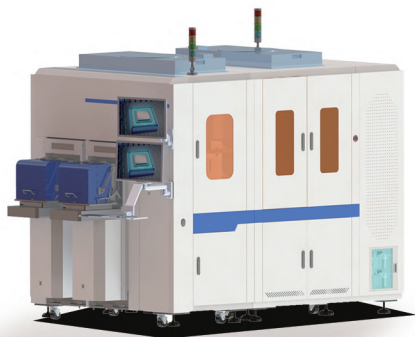
Dolphin 100 Series

Wafer Appearance Inspection Equipment



4 Inch & 6 Inch 亚微米量级
二维图形缺陷检测

8 Inch & 12 Inch 亚微米量级
二维图形缺陷检测



*气泡、溢胶、刮伤、变色、感光区脏污、Particle 等表面缺陷。

产品特点

自研大视野预对位系统:

兼容无Notch口晶圆产品, 提升设备兼容性和检测效率



专业缺陷检测算法:

实现低灰阶差缺陷检出, 有效降低过漏检



高精度明暗场成像分析:

明暗场照明和高分辨率成像系统, 提升缺陷对比度



集成离线复检功能:

集成在线自动光学检测和离线复检功能于一体, 可实现高效产出



■ 面向COMS图像传感器、AR、VR、玻璃光学镜头等。

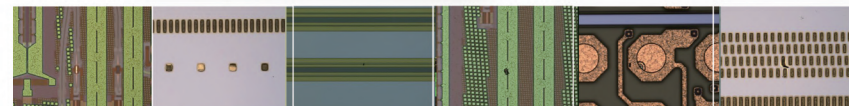
Dolphin 200 Series

Wafer Appearance Inspection Equipment



4 Inch & 6 Inch 亚微米量级
二维图形缺陷检测

8 Inch & 12 Inch 亚微米量级
二维图形缺陷检测



*金属缺失、金属残留、刮伤、变色、RDL、Golden Bump、Particle 等表面缺陷。

产品特点

关键尺寸量测技术:

具备CD量测技术, 提供关键尺寸量测解决方案



高精度明暗场成像分析:

明暗场照明和高分辨率成像系统, 提升缺陷对比度



自研高速同步技术:

利用高速同步技术, 快速且高效地处理大量数据, 提升整体效率



便捷UI设计:

操作软件采用便捷UI设计, 提升操作效率和体验



■ 面向Logic、MEMS、Memory、RF、Power、FOWLP、WLCSP、Bumping、Chiplet等。



关注精测
了解更多

服务支持, 敬请联系:

027-87002120

mkt@jcdz.cc